

# 数字电路高层次综合设计 第一周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期：2020 年 9 月 11 日

作业内容：

- 数字系统的实现方式有哪些？各有什么优缺点？
- 简述“片上系统 (System on Chip, SOC)”
- 什么是 Top-Down 设计模式？优缺点是什么？
- 数字系统设计过程中，“设计说明书 (Specification, Spec)”的作用是什么？通常包含哪些内容？

## Problem 数字系统的实现方式有哪些？各有什么优缺点？

按照设计方式分：

- 全定制：设计人员完成所有晶体管和互连线的详细版图，以标准逻辑器件以及外围电路组成，一般具有很高的性能，根据提供的接口进行搭积木式设计，几乎没有灵活性且成本以及复杂度很高
- 半定制：标准单元式设计，标准单元库如门阵列与标准模块等有助于提高布局布线效率，自动化程度高，设计周期短，ASIC 广泛使用
- 可编程：基于 FPGA 等可编程逻辑器件，灵活度高，周期短，上市快，但是存在功耗大，成本高，速度慢的问题

## Problem 简述“片上系统 (System on Chip, SOC)”

SoC 是将一种电子系统集成到单一的芯片上的一种方式，一般具有

- 微控制器或者数字信号处理器
- 存储器
- 提供时间信号的晶振等
- 计数器等外设
- 标准接口，如串口、网线等
- DAC 以及 ADC 完成数模转换
- 电源模块维持工作

并且可以在外部进行编程控制。

对比传统的传统基于主板的 PC 体系结构形成对比，后者基于功能分离组件。与具有等效功能的多芯片设计相比，集成程度更高的设计可以提高性能并减少功耗以及面积。但是这是以减少组件的**可替换性**为代价的。

SoC 广泛的应用到嵌入式系统、移动计算、计算机等。

## **Problem 什么是 Top-Down 设计模式？优缺点是什么？**

即自顶向下的设计方式，从系统级设计出发，逐步深入到行为级与 RTL 级设计，并对其仿真、综合、后仿真的迭代逐渐满足设计需求。

优点是全局出发，逐渐分析需求，将系统分割为子系统，递归应用此过程直到不可分割，可以从全局的角度对设计进行评估，加快了设计的流程，并且提高了模块复用性，可以应用于超大型的集成电路设计。

缺点是需要大量的 EDA 工具的辅助，而不是仅仅通过原理图以及版图进行辅助，对 EDA 的要求很高，并且不能预先估测设计的芯片子系统的物理属性即面积功耗等。

## **Problem 数字系统设计过程中，“设计说明书 (Specification, Spec)”的作用是什么？通常包含哪些内容？**

Spec 是一种架构层次的定义，可以用于沟通 SoC 设计者、PCB 厂家以及消费者。对芯片解决的需求进行明确，对功能进行定义，对模块进行划分，并且提出可行的解决方案和后续的维护方案。

包括：

- 需求 spec
- 功能 spec
- 设计或产品实现 spec
- 维护方案 spec